

開示の要約

研磨装置および研磨方法

- 5 研磨パッドの研磨面上の研磨液、薬液等の液体量の分布そのものをモニタリングし、ウェーハなどの被研磨物を適切な研磨条件で研磨することができる研磨装置が開示される。研磨装置は、研磨パッドを支持する研磨テーブルと、被研磨物Wを研磨パッドの研磨面に対して押し付ける研磨ヘッドと、研磨面上に液体を供給する液体供給装置と、研磨面上の複数点からの光に含まれる光学情報を取得する液体モニタリング装置と、光学情報から研磨面上の液体量の分布を決定する光学情報解析部と、研磨装置の動作を制御する動作制御部を備えている。
- 10

図 1